



科技行业前瞻研究-科先锋系列 报告 255 : PETER BANNON-特斯拉芯片架构奠基者



特斯拉的下一代 FSD 芯片将为 HW4.0，将由台积电代工，将以 4nm 或 5nm 工艺并使用该公司最新的 InFO_SoW 封装技术，即可在不需基板及 PCB 板的情况下将高性能计算芯片和散热模块封装在一起以特斯拉 FSD 的性能参数看，4.0 并不会在算力上出现飞跃式的提高，并基于成本的考虑，可能会在 D1 芯片的基础上开发 HW4.0

Dojo 超级计算机方面，DOJO 因为使用了 7nm 工艺芯片，整体研发设计的费用较高，从研发成本角度并不比购买市场上的 GPU 集群更具经济效益。因此未来以付费 IaaS 的方式开放 DOJO 训练服务给同样有需要进行云端训练加速的用户使用将会是 DOJO 下一步的一个重要发展方向。

关键词: GPU 特斯拉 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49966

